



HPI

TE 内部编号 1470224-9

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 9 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Signal, HPI

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 2.5 mm Headers



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 9

行数: 1

[所有 AMP HPI 2.5 mm Headers \(78\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 部分带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 9  |
| 行数       | 1  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 象牙色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 接合插针直径 | .7 mm[.027 in] |
|--------|----------------|



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光              |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | 1.27 μm[50 μin] |
|                    | 50 μin          |
| 端子布局               | 直插式             |
| 端子基材               | 黄铜              |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡               |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 亮光              |
| 端子接触部电镀材料          | 锡 (Sn)          |
| 端子类型               | 插针              |
| 端子额定电流（最大值）        | 3 A             |

端接特性

|               |                |
|---------------|----------------|
| 端接柱体和尾部直径     | .7 mm[.027 in] |
| 每个柱体的端接数（最大值） | 3              |
|               | .14 in         |
| PCB 端接方法      | 通孔 - 焊接        |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合固定     | 不带  |
| 接合对准类型   | 极化  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 带有  |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 尼龙 66 GF        |
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |
|------------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准



|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |          |
|------|----------|
| 封装数量 | 300      |
| 封装方法 | Bag, Box |

产品合规性

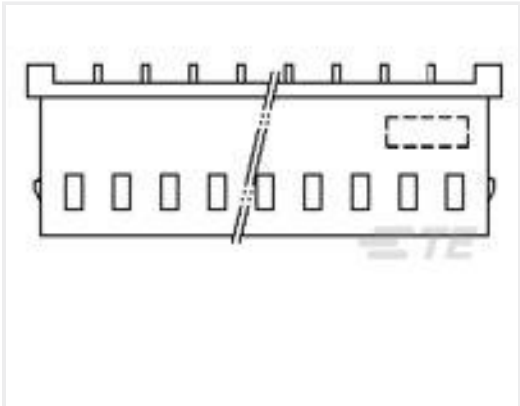
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2008年10月（15）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                                         |

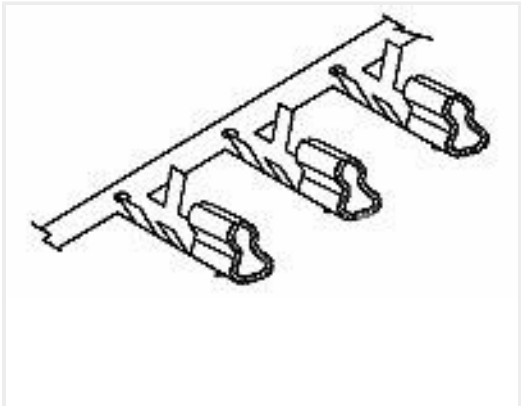
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



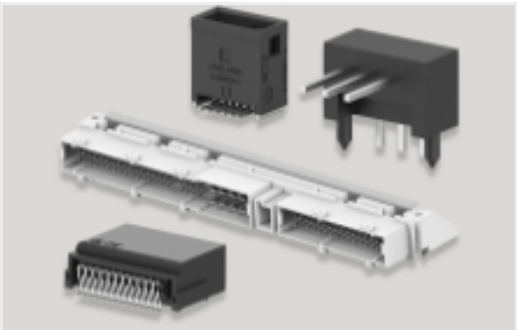
TE 产品编号 1470222-9  
[HPI 2.5MM EMIX HOUSING 9P](#)



TE 产品编号 1470223-1  
[HPI 2.5mm EMIX Terminal](#)

该系列中的其他产品 | [HPI](#)





PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(86)



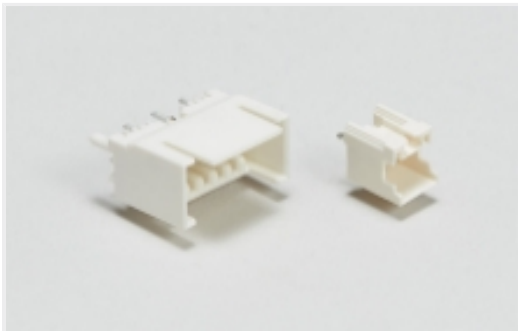
矩形电源连接器(310)



矩形连接器壳体(86)



线到板连接器组件和护套(48)

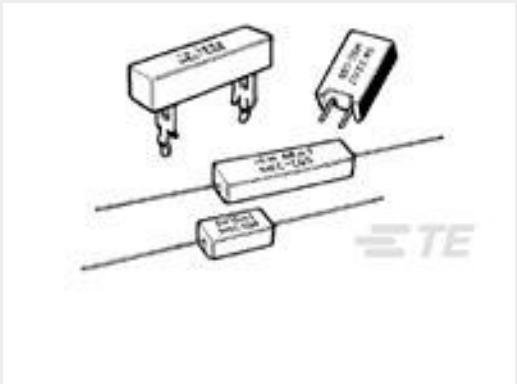


线到板接头和插座(332)



连接器端子(1)

客户还购买了



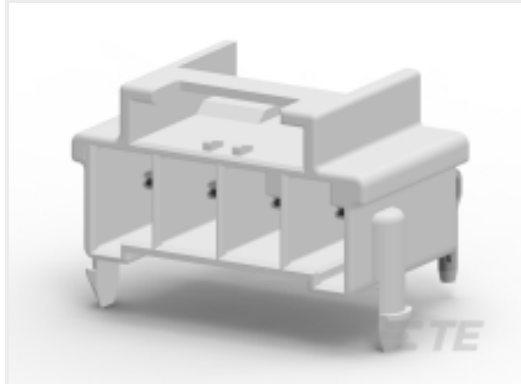
TE 产品编号2-1623795-3  
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号YD369-B99-AP400000  
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN



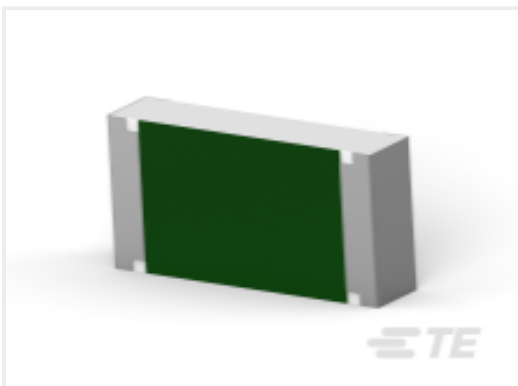
TE 产品编号YD369-B99-NP400000  
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN



TE 产品编号1-1969694-4  
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号YD369-B99-NS400000  
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,SKT



TE 产品编号9-2176397-4  
3502 7K5 1%



TE 产品编号1-1630019-4  
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001  
RECP ASSY

文档



HPI 2.5MM EMIX A'SSY V/T 9P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1470224-9\_E1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1470224-9\_E1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1470224-9\_E1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HPI Connectors QRG

英文版本

AMP 2.5mm PITCH EMIX WTB SYSTEM.

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本